

# Embedded Module

Open Standard Module™ - iesy EHL OSM-LE

## Technical Concept

- ▶ Platform: Intel® Elkhart Lake
- ▶ Arbeitsspeicher: 4 GByte
- ▶ Flash Speicher: 64 GB eMMC (only for eMCP version)
- ▶ Abmessung: 45 mm x 45 mm
- ▶ Footprint: OSM Size-L  
Land Grid Array (LGA) mit 662 Kontaktpunkten
- ▶ Spannungsversorgung: 5V über LGA Kontakte
- ▶ Software: Windows / Yocto Linux
- ▶ Temperaturbereich:
  - > Im Betrieb: 0 °C bis +70 °C
  - > Lagerung: -40 °C bis +85 °C
- ▶ Funktionen & Schnittstellen
  - > 3x Ethernet 100M/1G (2x RGMII, 1x SGMII)
  - > 2x USB 2.0 Host
  - > 2x USB 3.0 Host with USB 2.0 support
  - > 4x UART (2x with RTS/CTS)
  - > 13x GPIO, 4x PWM
  - > 3x SPI (1x connected to BIOS & TPM)
  - > 2x I2C, 2x I2S
  - > 2x SDIO (1x 4 bit, 1x 8bit)
  - > 1x CAN (CAN-FD), 1x JTAG
  - > 2x PCIe x1
  - > 4x PCIe x1 / 2x PCIe x2 / 1x PCIe x4 / 1x PCIe x2 + 2x PCIe x1
  - > 2x PCIe x1 / 1x PCIe x2
  - > 1x eDP (4 lanes), 1x DP/HDMI (2 lanes)



## Über OSM™

Die Open Standard Module™ Spezifikation wurde 2019 von der SGeT e.V. verabschiedet. Der neue Standard wurde entwickelt, um zukünftigen Anforderungen in Bezug auf **Flexibilität**, **Skalierbarkeit**, aber auch der **Kostenreduktion** gerecht zu werden. OSM™-Auflötmodule können individuell an die jeweiligen Kundenanforderungen angepasst werden. Dazu können die einzelnen Module mittels Tray & Reel im **SMT-Prozess** automatisch verarbeitet werden. Die OSM™ Serie umfasst insgesamt vier verschiedene Formfaktoren.



[iesy.com/osm](https://iesy.com/osm)